

2018年12月26日

各 位

会社名 シャープ株式会社  
代表者名 取締役会長兼社長 戴 正 呉  
(コード番号 6753)

## 会社分割による電子デバイス事業及びレーザー事業の分社化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年4月1日を効力発生日として、当社のIoTエレクトロデバイスグループに属する電子デバイス事業の一部（以下、「電子デバイス事業」といいます。）及びレーザー事業（以下、「レーザー事業」といいます。）を、今後当社の子会社として新設する会社2社（以下、「受皿会社」といいます。）にそれぞれ吸収分割で承継させることにより分社化すること（以下、「本分社化」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は完全子会社への吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

### 1. 本分社化の目的

当社は、企業価値向上に向け、構造改革を継続しつつ、事業ビジョン「8KとAIoTで世界を変える」を実現する企業へのトランスフォーメーションを進めております。

かかる中、当社は、事業環境の変化に機敏に対応するため、電子デバイス事業及びレーザー事業をそれぞれ新設する子会社への吸収分割により分社化し、より自律的な事業体制を構築することを決定いたしました。

### 2. 本分社化の要旨

#### (1) 日程

取締役会決議日	2018年12月26日
受皿会社の設立	2019年1月（予定）
分割契約締結日	2019年1月30日（予定）
実施予定日(効力発生日)	2019年4月1日

#### (2) 分社化の方式

当社出資の受皿会社として、シャープ福山セミコンダクター株式会社（以下、「SFS社」といいます。）及びシャープ福山レーザー株式会社（以下、「SFL社」といいます。）を設立します。

これらの受皿会社を吸収分割承継会社とし、当社を吸収分割会社として、それぞれ後記(6)記載の事業を吸収分割により承継いたします（以下、併せて「本吸収分割」といいます。）。当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割、SFS社及びSFL社においては会社法796条第1項に定める略式吸収分割に該当するため、両社とも株主総会の決議を経ずに実施する予定です。

#### (3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割に際して、SFS社及びSFL社から当社への株式の割当、金銭その他の財産の交付はありません。

#### (4) 本吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行する新株予約権に関する取扱いに変更はありません。

#### (5) 本吸収分割により増加する資本金

本吸収分割に際して当社並びにSFS社及びSFL社の資本金の増減はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

① SFS社が承継する権利義務

半導体及び半導体応用デバイス/モジュール事業、オプトデバイス事業、高周波デバイス及び高周波応用モジュール事業並びに半導体ファウンドリー事業に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務を、当社とSFS社との間で締結する吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

② SFL社が承継する権利義務

レーザー及びレーザー応用デバイス/モジュール事業に属する資産、負債及びこれらに付随する権利義務を、当社とSFL社との間で締結する吸収分割契約書に定める範囲において承継します。

(7) 債務履行の見込み

当社並びにSFS社及びSFL社の債務の履行の見込みには問題がないものと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

(1) 吸収分割会社

① 名 称	シャープ株式会社	
② 所 在 地	大阪府堺市堺区匠町1番地	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長・戴 正 呉	
④ 主 な 事 業 内 容	電気通信機器・電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製造・販売等	
⑤ 資 本 金	5,000 百万円	
⑥ 設 立 年 月	1935 年 5 月	
⑦ 発 行 済 株 式 数	533,411,921 株	
⑧ 決 算 期	3 月 31 日	
⑨ 大株主及び持株比率	鴻海精密工業股份有限公司	24.4%
	Foxconn (Far East) Limited	17.2%
	Foxconn Technology Pte. Ltd.	12.1%
	SIO International Holdings Limited	6.9%
⑩ 直前事業年度の連結経営成績及び連結財政状態		
純 資 産	401,713 百万円	
総 資 産	1,908,461 百万円	
1 株 当 たり 純 資 産	267.48 円	
売 上 高	2,427,271 百万円	
営 業 利 益	90,125 百万円	
経 常 利 益	89,320 百万円	
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	70,225 百万円	
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	106.07 円	

(2) 吸収分割承継会社

	SFS 社	SFL 社
① 名 称	シャープ福山セミコンダクター株式会社	シャープ福山レーザー株式会社
② 所 在 地	広島県福山市大門町旭1番地	広島県福山市大門町旭1番地
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役・森谷 和弘	代表取締役・森谷 和弘
④ 主 な 事 業 内 容	電子デバイス（半導体、LSI、センサー等）の企画・開発・生産等	半導体レーザーの企画・開発・生産等
⑤ 資 本 金	30 百万円	30 百万円

⑥ 設 立 年 月	2019年1月(予定)	2019年1月(予定)
⑦ 発 行 済 株 式 数	1,200株(予定)	1,200株(予定)
⑧ 決 算 期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率	当社100%	当社100%

※吸収分割する承継会社は両社とも今後設立予定であり、直前事業年度の経営成績等はございません。

#### 4. 分割する事業の概要

	SFS社に対し分割する事業	SFL社に対し分割する事業
① 事 業 内 容	半導体及び半導体応用デバイス/モジュール事業、オプトデバイス事業、高周波デバイス及び高周波応用モジュール事業並びに半導体ファウンドリー事業	レーザー及びレーザー応用デバイス/モジュール事業
② 営 業 成 績 (2018年3月期)		
売 上 高	73,500百万円	12,900百万円
③ 分割する資産、負債の項目及び帳簿価額 (2018年9月30日時点)		
流 動 資 産	7,735百万円	3,565百万円
固 定 資 産	4,435百万円	2,970百万円
流 動 負 債	130百万円	0百万円
固 定 負 債	10百万円	0百万円

※営業成績には、他セグメントへの内部売上高を含んでおります。

#### 5. 本吸収分割後の状況

当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

SFS社及びSFL社の所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はない予定です。

#### 6. 今後の見通し

本吸収分割は子会社への吸収分割であるため、当社連結業績への影響は軽微です。

以 上